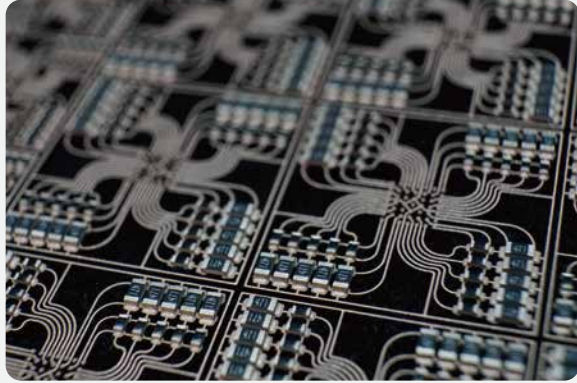


# 저온 경화형 부품실장용 페이스트

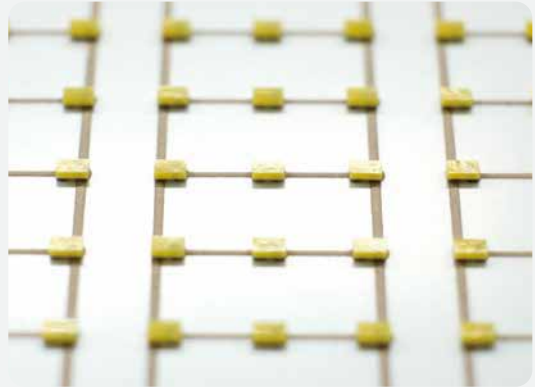
납땀이 불가능한 저내열 기재에도 매우 적합

## 용도

### 부품실장용도



이미지 : 글라스 웨이퍼에 실장



이미지 : 폴리이미드 기판에서의 LED 소자 실장

## 특징

- 저온 실장이 가능
- 우수한 밀착성
- 우수한 응력 완화성



0201 칩 실장도 가능

## 라인업 & 특성

제품 품번			AE8010
점도	BH형	dPa·s	1,000 ~ 1,500
경화조건	본경화		120°C×30분
체적저항율 [대표치]		Ω·cm	1.5E-04
열전도율		W/mK	10

